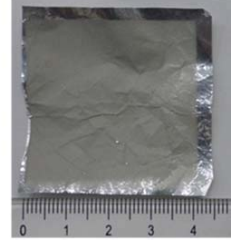
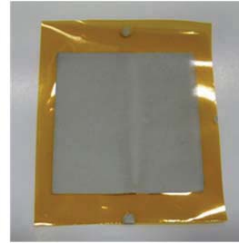
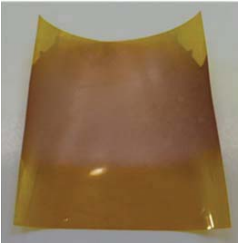
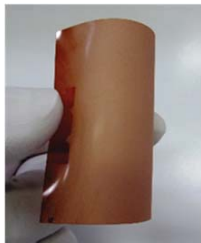
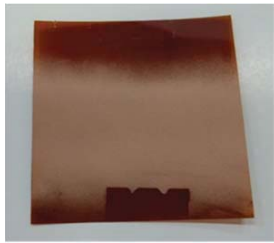


コールドソフトコートの施工例

●フィルム、箔等の軟基材への施工例

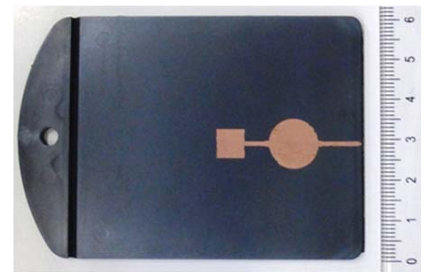
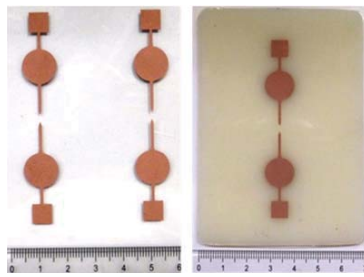
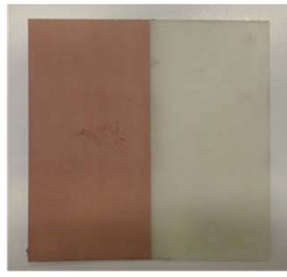


基材:ポリイミドフィルム(Kapton)125 μ m
粉末:銅等、厚さ約5~20 μ m

基材:ポリイミドフィルム(Kapton)25 μ m
粉末:銅、錫(Sn)等 厚さ約5 μ m

基材:アルミフویل、
粉末:銅、錫(Sn) 厚さ10~20 μ m

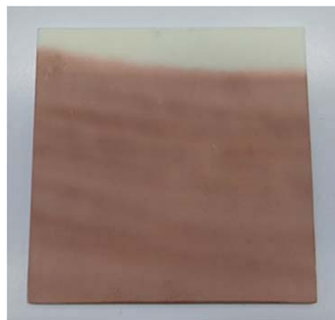
●低強度基材への施工例



基材:EMS製 高機能 ポリアミド板
100x100x2t
粉末:銅、厚さ10~30 μ m

基材:EMS製 高機能 ポリアミド板
パターン描写
粉末:銅 厚さ10~30 μ m

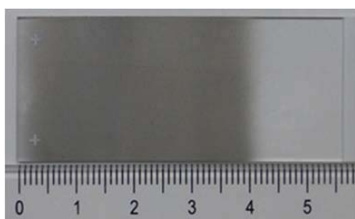
基材:樹脂
パターン描写
粉末:銅 厚さ10~20 μ m



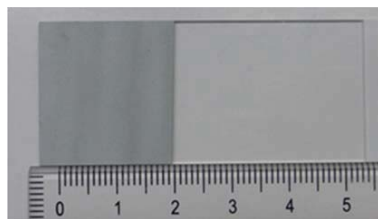
基材:セラミック アルミナ板 100x100x3t
粉末:銅、アルミ等、厚さ約5~30 μ m



基材:FRP厚板、粉末:銅
厚さ10~30 μ m



基材:ガラス 粉末:ニッケル(Ni)
厚さ10~30 μ m



基材:ガラス 粉末:亜鉛(Zn)
厚さ10~30 μ m



基材:ガラス 粉末:錫(Sn)
厚さ10~30 μ m